

## 質疑応答

### 説明会概要

2022年3月3日（木）10:00-11:00

Zoom ウェビナー

機関投資家・アナリスト向け

**質問 1.** なぜ無粗化技術が必要とされているのか。また、無粗化技術の開発の進捗について教えてほしい

回答 必要とされる理由の一つ目は、高周波対応のためです。電気信号が非常に速いスピードで導体表面を流れていくと、粗化形状が邪魔になりスピードが落ちると言われています。無粗化であればその損失がありません。これが理由の一つです。ただ、粗化をしても非常に僅かな粗化、例えば当社技術のような $0.1\mu\text{m}$ 程度の超微粗化であれば、ほとんど伝送ロスはないという結果も出ているので、必ずしも絶対無粗化でないといけないかはまだ分かりません。ただし、間違いなく無粗化は、電気信号の伝送ロスには有効であることが言えます。もう一つに、パッケージ基板のさらなる微細化で、できれば凹凸がない方がいいという理由があります。

開発の進捗については、当社は21世紀に入ってから無粗化の研究開発をしており、5、6年前に一部特殊な無粗化のプロセスに関しては量産されました。例えば、スパコンに使用されています。さらに、微細かつ複雑な構造のパッケージ基板にも使われるような無粗化プロセスは、開発を進めていきます。

**質問 2.** 新しい国内の新拠点は主に何をつくるのか。今までと変化があるのか。2025年完成後トータルの生産能力は何割程度増えるのか。

回答 今のところ主要な製品として、主力のCZ-8101等のCZ系を想定しています。ただし、より微粗化に対応する製品等の増え方に応じて柔軟に対応できるような設備計画にしておきたいと考えています。生産能力は、現状の日本国内生産能力に対し50%は増える計画ですが、土地を広めに取得し増設ができるような考え方がまず一つ。また、例えば2倍近くに増えた場合、別途、既存の尼崎工場・長岡工場を増強させる。それはあまり大きな投資ではありません。そうすることで生産性を上げ、生産量を増加していきます。